

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS PATENTOWY**

(19) **PL** (11) **238034**

(13) **B1**

(21) Numer zgłoszenia: **429894**

(51) Int.Cl.

E04F 15/04 (2006.01)

G01N 33/46 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2019**

(54) **Sposób ciągłego monitorowania parametrów podłóg drewnianych
oraz mikroklimatu w miejscu ich ułożenia**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

16.11.2020 BUP 24/20

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

28.06.2021 WUP 13/21

(73) Uprawniony z patentu:

**PANKIEWICZ-GRUBSKA MAŁGORZATA,
Gdynia, PL**

PANKIEWICZ MAGDALENA, Gdynia, PL

PANKIEWICZ BARTOSZ, Gdynia, PL

(72) Twórca(y) wynalazku:

**MAŁGORZATA PANKIEWICZ-GRUBSKA,
Gdynia, PL**

MAGDALENA PANKIEWICZ, Gdynia, PL

BARTOSZ PANKIEWICZ, Gdynia, PL

(74) Pełnomocnik:

rzecz. pat. Jan Prościński

PL 238034 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego monitorowania parametrów podłóg drewnianych oraz mikroklimatu w miejscu ich ułożenia, przy czym parametry obejmują wilgotności i temperatury.

W aktualnym stanie techniki w miejscu układania podłogi drewnianej dokonuje się pomiaru wilgotności wylewki betonowej oraz specjalnym urządzeniem pomiarowym wilgotności desek podłogowych przed ich układaniem. Na wskutek zmiennych warunków mikroklimatu deski podłogowe mogą ulegać odkształceniom. Producent w sporze z użytkownikiem nie dysponuje wiedzą czy mikroklimat oddziałujący na deski podłogowe jest zgodny zaleceniem producenta. Procesy montażowe są bardzo skomplikowane i pracochłonne, równocześnie nie zapewniające uzyskiwania gwarancji trwałości połączeń i właściwego terminowego wykorzystywania.

Powyższe mankamenty zostały wyeliminowane w rozwiązaniu według wynalazku, w którym mikroprocesorowy moduł uzyskuje temperaturę i stopień wilgotności w górnej przestrzeni nad drewnianą podłogą zaś mikroprocesorowy moduł uwidacznia wyniki pomiaru temperatury i stopnia wilgotności w przestrzeni pod podłogą drewnianą oraz przedstawia wyniki pomiaru o identycznym jak wyżej zakresie pomiaru dokonanego przez zespół pomiarowy szpilek osadzonych w podłodze x uzyskując sumaryczny zestaw pomiarów eksploatacyjnych badanej podłogi.

Rozwiązanie według wynalazku zapewnia ciągłą rejestrację parametrów desek podłogowych oraz parametrów mikroklimatu z datą i miejscem odczytu. W przypadku sporu producenta z użytkownikiem może być dowodem udawadniającym winę. Podobną informację otrzymuje użytkownik na urządzenie mobilne w wyniku której może podjąć działania ochraniające deski podłogowe przed zniszczeniem – włączenie lub wyłączenie ogrzewania, lub przeprowadzenie odpowiedniej regulacji ogrzewania podłogowego.

W rozwiązaniu według wynalazku skompensowanie parametrów temperatury i wilgotności podłóg drewnianych z warunkami termicznymi miejsca operacji montażowych pozwoliło na uzyskanie nieoczywistego efektu doboru ilościowego i wielkościowego poszczególnych operacji technologicznych, a w konsekwencji uzyskanie wysokiej jakości i trwałości składanych podłóg drewnianych.

Przedmiot wynalazku uwidoczniono na materiale ilustracyjnym przedstawiający schematycznie układ ciągłego monitorowania wilgotności i temperatury podłóg drewnianych.

Tak jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym zewnętrzny mikroprocesorowy moduł A połączony z Internetem cyklicznie odczytuje wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z ułożoną podłogą drewnianą D, oraz za pomocą łączności bezprzewodowej cyklicznie odczytuje wartość temperatury i wilgotności z modułu mikroprocesorowego B umieszczonego pod podłogą i połączonego z deską za pomocą elektronicznego pomiarowego zespołu szpilekowego C.

Zastrzeżenie patentowe

1. Sposób ciągłego monitorowania parametrów podłóg drewnianych oraz mikroklimatu w miejscu ich ułożenia **znamienny tym**, że mikroprocesorowy moduł (**A**) uzyskuje temperaturę i stopień wilgotności w górnej przestrzeni nad drewnianą podłogą (**D**), zaś mikroprocesorowy moduł (**B**) uwidacznia wyniki pomiaru temperatury i stopnia wilgotności w przestrzeni pod podłogą drewnianą (**D**) oraz przedstawia wyniki pomiaru o identycznym jak wyżej zakresie, pomiaru dokonanego przez zespół pomiarowy szpilek (**C**) osadzonych w podłodze (**D**), uzyskując sumaryczny zestaw pomiarów eksploatacyjnych badanej podłogi (**D**).

Rysunek

